温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。如果后IO模块出风口温度没有下降,告警仍然一直存在,会导致系统温度进一步升高,产生其它更高级别的告警。因此,产生高温告警应尽早发现可能存在的问题,避免问题升级。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。如果后IO模块出风口温度没有下降,告警仍然一直存在,会导致系统温度进一步升高,产生其它更高级别的告警。因此,产生高温告警应尽早发现可能存在的问题,避免问题升级。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。如果后IO模块出风口温度没有下降,告警仍然一直存在,会导致系统温度进一步升高,产生其它更高级别的告警。因此,产生高温告警应尽早发现可能存在的问题,避免问题升级。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。如果前IO模块进风口温度没有下降,告警仍然一直存在,会导致系统温度进一步升高,产生其它更高级别的告警。因此,产生高温告警应尽早发现可能存在的问题,避免问题升级。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。如果前IO模块进风口温度没有下降,告警仍然一直存在,会导致系统温度进一步升高,产生其它更高级别的告警。因此,产生高温告警应尽早发现可能存在的问题,避免问题升级。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。如果前IO模块进风口温度没有下降,告警仍然一直存在,会导致系统温度进一步升高,产生其它更高级别的告警。因此,产生高温告警应尽早发现可能存在的问题,避免问题升级。

温度过高会导致硬盘背板和主板器件运行不稳定,影响设备寿命,增加能耗;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

计算模块温度过高,会导致CPU运行不稳定;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

温度过高会导致器件运行不稳定,影响设备寿命,增加能耗;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

温度过高会导致器件运行不稳定,影响设备寿命,增加能耗;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

温度过高会导致器件运行不稳定,影响设备寿命,增加能耗;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

温度过高会导致器件运行不稳定,影响设备寿命,增加能耗;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

温度过高会导致器件运行不稳定,影响设备寿命,增加能耗;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

温度过高会导致器件运行不稳定,影响设备寿命,增加能耗;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

温度过高会导致器件运行不稳定,影响设备寿命,增加能耗;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

内存温度过高,会导致内存运行不稳定;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

VDDQ温度过高,会导致VDDQ运行不稳定,无法为CPU正常供电;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

VRD温度过高,会导致VRD运行不稳定,无法为CPU正常供电;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

CPU产生温度过高紧急告警,系统启动自我保护,会强制主板下电,业务终止,未保存数据将会丢失说明产生该告警之前,会有CPUN Prochot、CPUN DTS传感器的告警,此时应及时对系统降温,避免温度进一步上升而产生此告警。

电源温度过高时,会降低电源模块寿命,影响系统供电;或使服务器下电,影响系统业务。

温度过高会影响设备各器件性能,出现运行不稳定的情况。

GPU卡温度过高,会导致GPU卡和主板器件运行不稳定,影响设备寿命,增加能耗;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

温度过高会导致器件运行不稳定,影响设备寿命,增加能耗;如果告警一直存在,设备会自动下电或重启,导致业务中断,数据丢失。

服务器自动关机,导致操作系统业务中断。

产生此告警时,系统不能正常上电。

影响系统供电。

可能导致服务器下电。

电源模块异常,影响设备供电。

电源冗余失效,降低设备供电可靠性。

可能导致系统停止响应。

可能导致系统停止响应。

可能导致系统停止响应。

可能导致系统停止响应。

可能导致系统停止响应。

可能导致系统停止响应。

可能导致系统服务器异常下电。

可能导致系统服务器异常下电。

可能导致系统服务器异常下电。

可能导致系统服务器异常下电。

可能导致系统服务器异常下电。

可能导致系统服务器异常下电。

影响系统稳定性,可能造成设备无法响应。

影响系统稳定性,可能造成设备无法响应。

影响系统稳定性,可能造成设备无法响应。

影响系统稳定性,可能造成设备无法响应。

主板上MOS管电压降异常,可能导致主板供电异常,系统无法正常运行。

影响系统供电。

影响系统供电。

影响系统供电。

影响系统供电。

影响系统供电。

影响系统供电。

影响系统供电。

影响系统供电。

影响系统供电。

影响系统供电。

操作系统重启,可能导致服务器业务中断。

操作系统下电,可能导致服务器业务中断。

操作系统下电再上电,可能导致服务器业务中断。

无法正常监控进风口温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控PCH芯片温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控CPU核心温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控CPUN DTS检测点的温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控CPUN VDDQ Temp检测点的温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控CPUN VRD Temp检测点的温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控CPU下属的内存的温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控主板上SYS NV检测点的电压,电压异常时无法及时告警。

无法正常监控主板上CPU VCore检测点的电压,电压异常时无法及时告警。

无法正常监控主板上CPU下属内存的电压检测点的电压,电压异常时无法及时告警。

无法正常监控RAID卡的温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控风扇模块的转速,影响风扇调速功能。

无法正常监控后置硬盘背板的温度检测点的温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控SSD卡的温度检测点的温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控SSD硬盘的温度检测点的温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控板载网卡的温度检测点的温度,温度异常时无法及时告警。

无法正常监控出风口温度,影响风扇调速功能。

无法正常监控服务器的输入功率,影响服务器功率封顶功能。

无法正常监控电源模块的输入功率,影响服务器功率封顶功能。

FRU数据出错,影响系统读取资产信息。

硬盘或SD卡故障会导致保存的数据无法读取,系统运行出现异常。

当RAID阵列出现异常或故障时,影响硬盘或SD卡的使用,导致系统的可靠性降低。

SD卡组成的RAID组失效,降低了系统的容错性能。

SD卡不可用,降低系统存储性能。

硬盘可靠性降低,可能影响系统存储性能。

影响系统散热功能,降低主板器件性能。

影响系统散热功能,降低主板器件性能。

影响系统散热功能,降低主板器件性能。

电源模块风扇故障会导致电源模块过热,引起电源模块异常,从而影响系统供电。

电源模块风扇故障会导致电源模块过热,引起电源模块异常,从而影响系统供电。

对应内存无法正常使用,影响服务器性能。

内存发生不可纠正错误时,可能会导致业务中断、系统停止响应或重启。

内存发生不可纠正错误时,可能会导致业务中断、系统停止响应或重启。

如果是CPU对应的第一个槽位内存出现该错误,则会导致系统无法启动;如果其它槽位的错误,则系统能启动,但对应内存不可用。

如果是CPU对应的第一个槽位内存出现该错误,则会导致系统无法启动;如果其它槽位的错误,则系统能启动,但对应内存不可用。

如果是CPU对应的第一个槽位内存出现该错误,则会导致系统无法启动;如果其它槽位的错误,则系统能启动,但对应内存不可用。

内存状态异常可能导致操作系统无法正常工作,主板重启和宕机。

l 主板电池故障,会使系统时间出错,保存在CMOS(Complementary Metal-OxideSemiconductor)上面的数据丢失,系统配置出现错误,系统运行出现异常。l RAID卡BBU电压出现故障,会影响RAID卡Cache数据的掉电保护功能。l 主板电池未安装或者电量低。l RAID卡BBU故障。

RAID卡iBBU或超级电容电压出现故障,会影响RAID卡Cache数据的掉电保护功能。

CPU内部错误会对主板系统业务性能造成影响,操作系统无法正常工作,可造成主板重启和无法响应。

CPU自检错误会导致系统无法正常启动;或启动后业务无法正常运行,影响业务性能。

系统无法正常启动。

系统无法正常启动。

CPU运行异常会导致业务中断或系统重启等情况,影响业务的运行。

部分内存不可使用,可能影响服务器性能。

总线故障可能导致业务中断、系统崩溃或重启。

由于无内存可用,系统无法启动。

PS/2或USB设备不可用。

连接到服务器的视频设备无法使用。

服务器可能无法正常使用。

CPU无法正常工作,系统无法启动。

SAS线缆连接错误会导致系统无法识别所有的硬盘。

硬盘背板异常会导致硬盘无法正常使用。

硬盘背板故障会影响背板的正常使用。

RAID卡功能不可用,无法读取硬盘数据,影响系统启动。

PCIe标卡无法正常使用。

不同类型的计算节点板混合使用,降低系统性能。

不同类型的内存板混合使用,降低系统性能。

不同类型的内存板混合使用,降低系统性能。

可能导致系统无法调度某些进程,影响系统性能。

可能导致某些进程被阻塞或新的进程无法运行,影响系统性能。

无法从LCD登录,进行信息查询以及相应的简单设置。

通信故障会使HFC无法正常获取服务器的全部信息,降低系统管理能力。

硬盘背板杂散信号线故障会导致硬盘无法正常使用。

硬盘背板杂散信号线故障会导致硬盘无法正常使用。

硬盘背板杂散信号线故障会导致硬盘无法正常使用。

Expander心跳丢失可能会导致业务系统不能正常访问硬盘。

系统可能出现无法响应或者重启的现象,降低系统稳定性。

可能导致系统停止响应或者重启。

可能导致系统停止响应或者重启。

可能导致系统无法上电。

可能导致系统无法上电。

可能导致系统无法上电。

可能导致系统无法上电。

无法识别NVMe硬盘,影响业务功能。